

## 究極の半導体素材ダイヤモンドを加工する

優れた材料特性を持つダイヤモンドは、これまで宝飾原石や砥粒等の工具素材として用いられてきた。更に近年は究極の半導体と称されその開発動向に注目が集まっている。しかし、その高い機械的材料特性のため加工が極めて困難であり、ダイヤモンド半導体の実用化の障壁の一つとなっている。品質の良い結晶を得ることと高効率な加工プロセスを確立することがダイヤモンド半導体の実用化につながり、ひいてはエコロジカルな社会の実現に寄与する。今回は、そんなダイヤモンドの加工に着目し、第一線で活躍する 4 名の研究者・技術者から最新情報を提供頂く。

主 催：公益社団法人 砥粒加工学会 次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会

日 時：2025 年 6 月 20 日（金） 13:00～17:00

開催方式：下記会場（対面）と Cisco Webex Meeting（Web）のハイブリッド形式で開催します。

会 場：日本大学 理工学部 駿河台キャンパス 1 号館 6 F CST ホール

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台 1-1

<https://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/surugadai/>



※ 講演者には開催前の状況により、対面か Web のどちらでの講演かを選択して頂きます。

※ Web 開催に関する詳細情報は、参加ご希望の方に後日通知いたします。

13:00～13:05	開会挨拶	委員長 日本大学 山田 高三 氏
13:05～13:55	講演1 「半導体基板用ダイヤモンドの現状と今後」	Element Six Ltd. Dermot O'Malle 氏
13:55～14:45	講演2 「単結晶ダイヤモンドのレーザスライシング」	東京科学大学 徳永大二郎 氏
14:45～15:05	<休 憩>	
15:05～15:55	講演3 「ダイヤモンド基板の紫外光援用研磨」	熊本大学 久保田章亀 氏
15:55～16:45	講演4 「プラズマ援用研磨による単結晶・多結晶ダイヤモンド基板の高効率サブナノ精度加工」	大阪大学 山村和也 氏
16:45～16:50	閉会挨拶・事務連絡	
17:10～19:10	技術交流会 日本大学駿河台キャンパス 1 号館 2F カフェテリア	

**参加費：研究会：**当専門委員会会員：無料，非会員：15,400 円（税抜額 14,000 円＋消費税 1,400 円），非会員アカデミア：6,600 円（税抜額 6,000 円＋消費税 600 円），学生：無料

※会員は 5 名／社まで、非会員は 2 名／社まで研究会に参加できます。

**技術交流会：**会員資格に関わらず 2 名／社まで参加できます。3 人目からは 4,950 円／人（税抜額 4,500 円＋消費税 450 円）を徴収します。

（注）「会員」とは専門委員会会員を指します。学会員ではございませんのでご注意ください。

（注）価格は消費税 10%を含みます。

**申込締切日：**2025 年 6 月 5 日(木)

（注）当日キャンセルの非会員には、すでに準備に費用がかかっているため参加費を請求致します。

**問合せ/申込先：**◆次世代固定砥粒加工プロセス専門委員会事務局

FAX：048-858-3709, E-mail：sf-office@mech.saitama-u.ac.jp

申し込みはホームページよりお願いいたします。→<https://jsat-sf.jp/event.html>